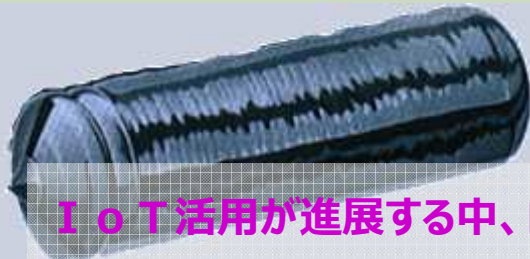


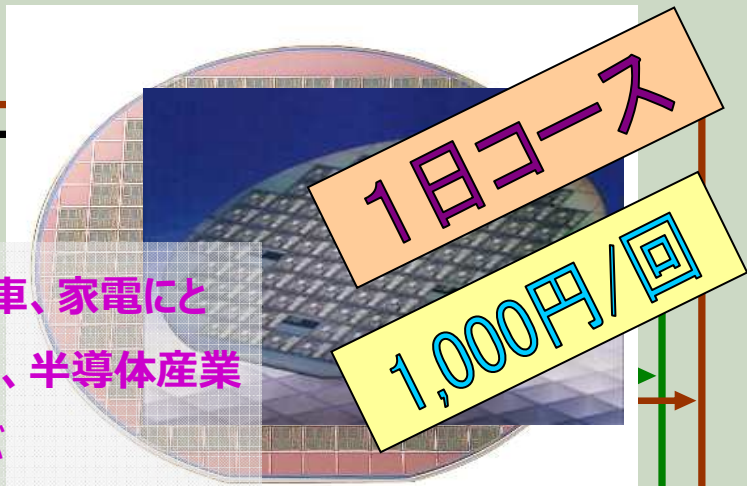
2016年度半導体基礎講座

設計

試作



①



I o T活用が進展する中、ロボット、車、家電にと
身近で利用されている半導体について、半導体産業
の概要や製造工程の基礎知識を学ぶ

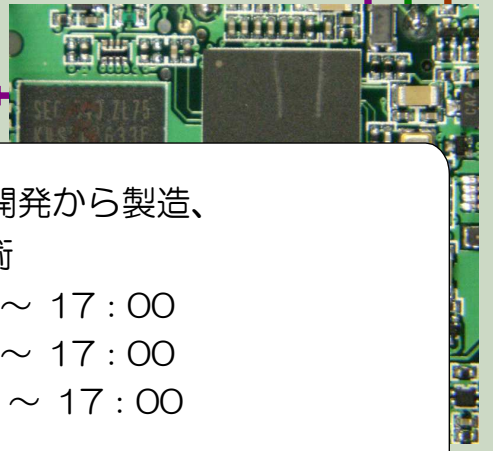


後工程
(組立て)

(組立て)



テスト



内 容

半導体産業の概要、および半導体製品の開発から製造、
テストにいたるまでの工程概要と要素技術

期 間

- ① 2016年7月21日(木) 時間9:00 ~ 17:00
 - ② 2016年7月28日(木) 時間9:00 ~ 17:00
 - ③ 2016年8月 4日(木) 時間9:00 ~ 17:00
- 1回のみでの参加も可能です。

会 場

大分県産業科学技術センター 2F 第1研修室
半導体製造工場

- ①(株)ジャパンセミコンダクター 大分事業所
- ②ルネサス セミコンダクタ パッケージ&テストソリューションズ(株) 大分工場
- ③(株)ジェイデバイス 臼杵工場

講 師

益子 洋治氏 (大分大学 電気電子工学科 教授)
筒井 信明氏 (半導体人材育成教育コンサルタント)

受講対象者

LSI クラスタ会員企業の方(技術・事務を問いません)または、
会員企業に就職予定の方

定 員

各講座 30名

講座のねらい・特徴

半導体産業・動向から半導体製造工程やテストについての基礎知識・要素プロセス技術を
短期間に学べる。

半導体産業・製造の基礎知識を学ぶことにより、今後従事する、または従事している
職務のレベルアップや改善が図れる。

当講座は「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」を利用している、
もしくは利用予定の事業所が外部委託訓練として利用できる講座です。
(制度の詳細は、最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい)

大分県LSIクラスタ形成推進会議

<http://www.cita-lsi.jp/>

半導体基礎講座（1日コース）〔2016年〕

| | |
|-----------------------------------|---|
| 半導体基礎講座① 7月21日（木） 講師：益子 洋治氏 | |
| 半導体産業の概要 | 半導体・LSIとは 人類社会を変革する半導体・LSI 半導体とは、LSIの基本構造 LSIを構成する基本素子の構造と原理 パワー系/センサー系半導体素子の基礎 |
| | 半導体産業の性格と現状 半導体産業の動向 半導体産業の特徴 |
| | LSIの技術動向 微細化技術 進化する半導体 |
| 工場見学（ジャパンセミコンダクター大分） （貸切バスで移動） | 半導体製造前工程（ウェーハ製造処理工程） |

| | |
|---|---|
| 半導体基礎講座② 7月28日（木） 講師：筒井 信明氏 | |
| 半導体製造工程概論 （組み立て、テスト） | LSI開発・製造の流れ LSI開発・製造の全体フロー 実装技術 |
| | 組み立て工程 パッケージタイプの変遷 パッケージング |
| | 半導体評価・テスト・解析 評価・テスト・解析の役割 評価 テスト 解析 |
| 工場見学（ルネサス セミコンダクタ パッケージ&テストソリューションズ） （貸切バスで移動） | 半導体製造後工程（組立て、テスト） |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 半導体基礎講座③ 8月4日（木） 講師：筒井 信明氏 | | |
| 半導体開発・製造工程概論 （ウェーハ製造） | LSI開発・製造の流れ LSI開発・製造の全体フロー | |
| | LSIの開発・設計 LSI開発の流れ 設計 フォトマスク | |
| | シリコンウェーハ シリコンウェーハの製造 シリコンウェーハ口径と平坦性の推移 | |
| | ウェーハ処理工程 ウェーハプロセス リソグラフィ工程 エッチング工程 洗浄工程 イオン注入工程 熱処理・成膜工程 配線および電極形成工程 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 工場見学（ジェイデバイス臼杵工場） （貸切バスで移動） | 半導体製造後工程（組立て、テスト） | |

参加申込規定

- 申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mail または FAX でお送りください。
- 参加費は開催前々日までに指定の銀行口座にお振込みください。
（振込み手数料はご自身でご負担ください）
- 申込人数が定員に達し次第締め切らせて頂きます。
- 申込人数が少ない場合、講座を延期もしくは中止することがあります。
- 工場見学はお断りさせていただく場合がございます。（受講料は半額返却）

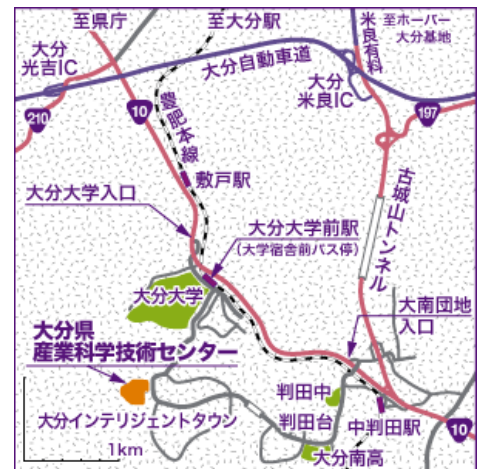
ご注意

- 録音機、カメラの持ち込みはご遠慮ください。
- テキストは会場でお渡しします。

振込先

大分銀行 判田支店 普通預金 5122818
口座名 大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局 島添 光法

会場



| コース名 | 回数 | 開催日 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| 半導体基礎講座①（半導体産業の概要） | 1 | 7月21日（木） |
| 半導体基礎講座②（半導体製造工程概論：組立て、テスト） | 1 | 7月28日（木） |
| 半導体基礎講座③（半導体製造工程概論：ウェーハ製造） | 1 | 8月4日（木） |
| 参加費（税込み） | 1,000円 / 回・人 | 会場 産業科学技術センター2F 第1研修室 |

※ 1回のみでの参加も複数回の参加も可能です。 ※ 参加費には、交通費、宿泊費、昼食等は含まれておりません。

お申込先

FAX (0977)72-9968 / E-mail et-course@elia-jp.com

〒879-1507 大分県速見郡日出町大字豊岡 799 番地 1 (株)エリア 後藤/日力 (0977)73-2485